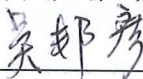
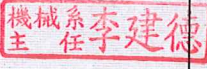










宏國德霖科技大學專任教師編撰教材獎助申請表

※粗線框內欄位請申請人務必填寫

申請日期：107年8月15日


申請人簽章	<input type="checkbox"/> (請申請人務必簽章) 	職稱	助理教授	單位	機械工程系
教材名稱	Moldex3D 模流分析		適用課程	模流分析	
申請類別 (請自行勾選)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 編撰課程教學所需教材，確實能提高教學成效者。 <input type="checkbox"/> 2. 產學研究計畫成果融入實務教材製作，確實能提升學生實務能力者。 <input type="checkbox"/> 3. 以本校名義參加校外與教學相關之教材製作競賽，獲得名次者。 <input type="checkbox"/> 4. 獲教育部數位教材認證通過者。				
申請 案 內 容 自 述	<p style="text-align: center;">主 題 內 容 (詳細內容、試驗方法、理念創新、依據學理) (以申請前一年9月1日至申請當年8月31日間之改善教學成果為限)</p>				
	<p>宏國德霖科技大學機械工程系已經多年沒有開設「模流分析」課程，今年(106 學年度)第二學期，特別為本屆參與技職再造計畫的同學再次開設「模流分析」課程。早期負責德霖技術學院(宏國德霖科技大學前身)機械工程系「模流分析」授課教師羅仕鵬老師早已高升本校校長，本系沒有老師有意願與興趣接手本門課程。機械系前主任蔡有藤教授指定本人來接手講授這門課程，本人懷著惶恐心情接下這個任務。接下任務後，開始展開搜尋與請益的工作。</p> <p>有多套套裝軟體可以執行模流分析工作，目前使用最多的是 Autodesk 公司的 Moldflow 與台灣科盛公司的 Moldex3D 軟體。由於本校藉由教育部補助款採購了 40 套 Moldex3D 模流分析軟體，所以決定將課程定位在使用現有的模流分析軟體 Moldex3D 來進行模流分析。然後，本人前往科盛公司參加一系列研習課程來了解與熟悉 Moldex3D 軟體。接著，嘗試尋找一本適合的出版物來做為教科書。經過網路利用 google 搜尋，台灣地區有全華出版社出版過相關書籍，分別在 2002 年出版由科盛股份有限公司編著的「CAE 模流分析技術入門與應用(一天學會 Moldex3D 模流分析軟體)」，及 2007 年出版科盛股份有限公司編著的「Moldex3D 模流分析技術與應用」，兩本書都是年代久遠、超過 10 年的古董書籍，已經絕版多時，並不適合拿來當教科書使用。科盛公司在 2017 年自行出版一本「真實三維模流分析技術與應用」是比較新的書籍。可是，該書內容較為簡略，對於本校學生而言，較不容易理解。基於以上原因，本人著手撰寫一本講義來當作宏國德霖科技大學機械工程系 106 學年度第二學期開設「模流分析」課程的授課教材。本教材參考了上述 3 本書籍及網路相關資訊，如果有雷同部分，版權屬於原作者。</p> <p>本講義以 Moldex3D R14 版本為標準撰寫(本學期上課將採用 R15 版本)，雖然經過多次的校稿與修訂，可能仍無法達到完美，如果有任何錯誤與疏失的地方，歡迎學生提出討論，日後如果再次開設「模流分析」課程，必當予以修正。</p>				
得獎名次			自製率	95%	
附件	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 編撰教材(請裝訂成冊，含封面及目錄) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 教學應用說明 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他教學成效佐證(如學生教材使用評估、同儕教師之評估…等) ※請一併檢附以上所列附件之電子檔予系上統一彙整。				

單位主管	教務處	改善教學 審核小組	人事室	會計室	校教評會	校長
業經 <u>107</u> 學年度第 <u>1</u> 學期第 <u>2</u> 次系(中心)教評會審查通過。 主管簽章： 	  	業經 <u>107</u> 年 <u>11</u> 月 <u>26</u> 日改進教學審核小組審查評定為 <u>優等</u> 第 <u>1</u> 次，建議獎助： <u>4790</u> 元。	  		業經 <u>107</u> 學年度第 <u>1</u> 學期第 <u>3</u> 次校教評會通過，獎助 <u>4790</u> 元	

註：1.請將附件欄位所列之資料檢附於8月31日前送所屬教學單位審核。

2.經所屬教學單位教評會審查通過後，請教師將申請表、評分表及相關附件電子檔寄至系助理電子信箱，由系上統一彙整燒錄光碟送至教務處。


業經107學年度第1學期
第 3 次院教評會審查
通過。

主管簽章：


編號：
(教務處填寫)

宏國德霖科技大學獎助改善教學評分表

※粗線框內欄位請申請人務必填寫

單位	機械工程系	申請人	吳邦彥
申請類別	<input type="checkbox"/> 改進教學(第 項) ; 競賽名次： <input type="checkbox"/> 製作教具(第 項) ; 競賽名次： <input checked="" type="checkbox"/> 編撰教材(第 1 項) ; 競賽名次：		
申請獎助名稱	Moldex3D 模流分析		
評分項目	一、主題內容：包含依據學理、理念創新、試驗方法 二、成果貢獻：成果應用於教學上之價值及具體貢獻 備註：以申請前一年9月1日至申請當年8月31日間之改善教學成果為限。		
總分	本申請案業經本校 107 年度 改進教學審查小組 107 年 11 月 26 日審查小組會議審查確定並評定 總分為 <u>87</u> 分，等第為 <u>優等</u> 。 審查小組召集人簽章： 		
備註	獎助等第分為特優、優等、良好、佳作等四級： 特優為90分以上，優等為85~89分，良好為80~84分，佳作為75~79分，不足75分不予獎助。		

宏國德霖科技大學教師申請改善教學獎助案

切 結 書

填表日期：中華民國 107 年 8 月 15 日

申請人姓名	吳邦彥	申請教師 所屬系科	機械工程系
申請類別	編撰教材第 1 項		
申請案名稱	Moldex3D 模流分析		

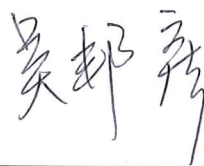
茲切結保證本人吳邦彥於 107 年度提出之改善教學獎助申請案相關內容，下列所述事項屬實：

- 一、無侵害他人著作權、專利權及其他智慧財產權利之情事，內容中若有屬於他人所有智慧財產權部分，皆已取得權利人之授權，並且依法標示作品來源。
- 二、無違反個人資料保護法相關規定，未經同意而洩漏他人個資之情事。
- 三、如有發生智慧財產權或個人資料保護之糾紛、訴訟，願自負法律責任。

此致

教務處

申請人簽章：



(請簽名蓋章)

註：請於申請時，一併檢附本切結書，未檢附者，不予受理。